



磊拓科技股份有限公司
晶圓檢測設備

點擊項目直達頁面

- [主要技術](#)
- [產品系列介紹](#)
- [總結](#)
- 型號 :
- [TWS206](#)
- [LFM SiC](#)
- [LFM I 型](#)
- [LFM II 型](#)
- [Edge-Profiler](#)
- [StressMap](#)



產品系列介紹

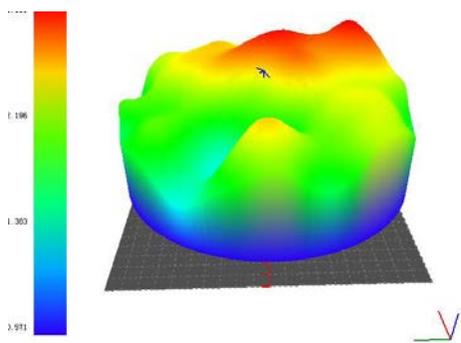


TWS206

4" · 6" · 8" · 12" wafer

TWS 形貌檢測設備

測量BOW/WARP/TTV/LTV/Thickness
(全自動, 半自動可定製)

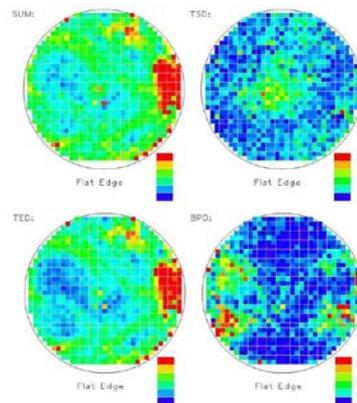


LFMSiC

4" · 6" · 8" wafer

LFMSiC碳化矽襯底檢測設備

測量SiC襯底晶體位元錯
(全自動, 半自動可定製)

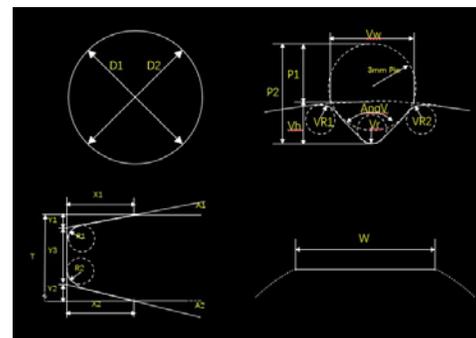


Edge-Profiler

4" · 6" · 8" wafer

晶圓倒角形貌檢測設備

測量直徑/厚度/倒角形貌,
平邊/缺口參數
(全自動, 半自動可定製)

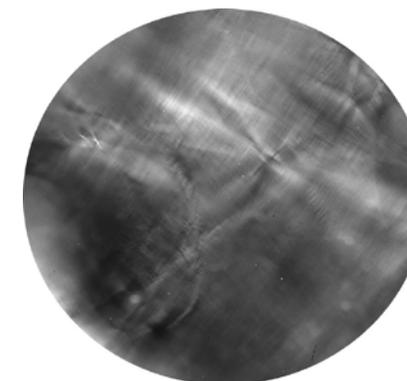


StressMap

4" · 6" · 8" wafer

應力檢測設備

測量芯片應力分佈
(全自動, 半自動可定製)



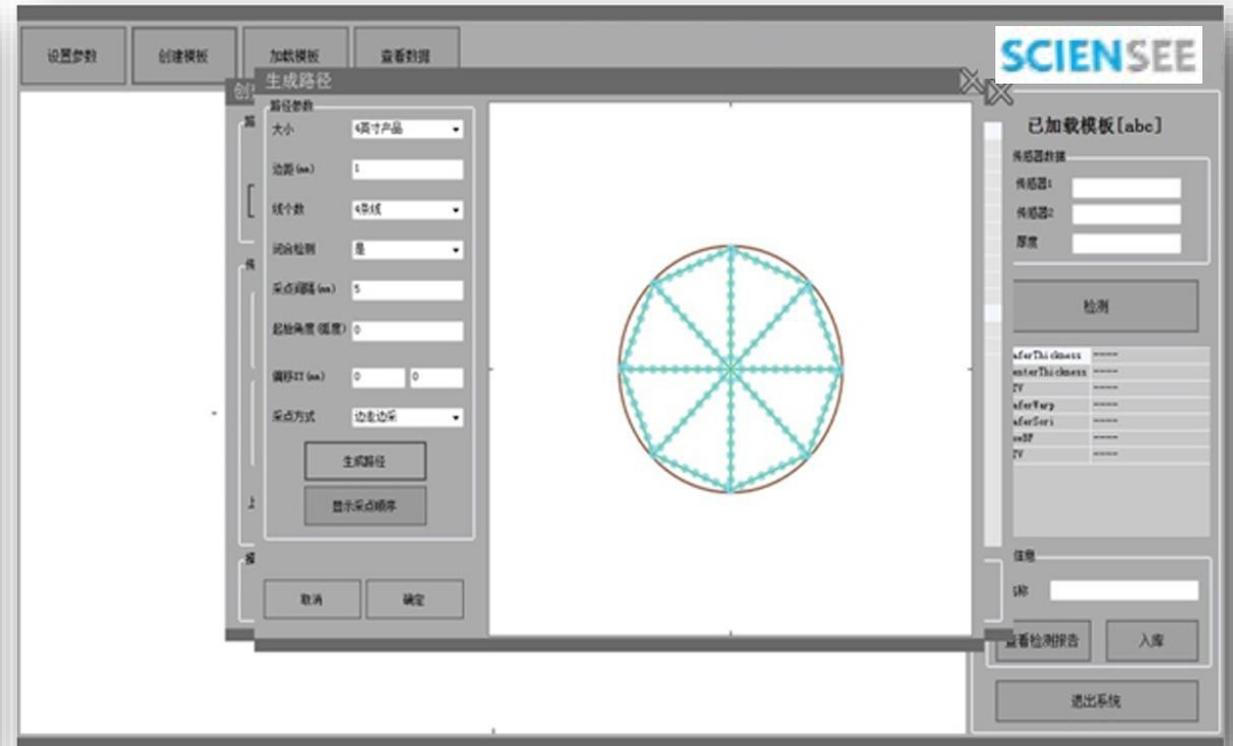
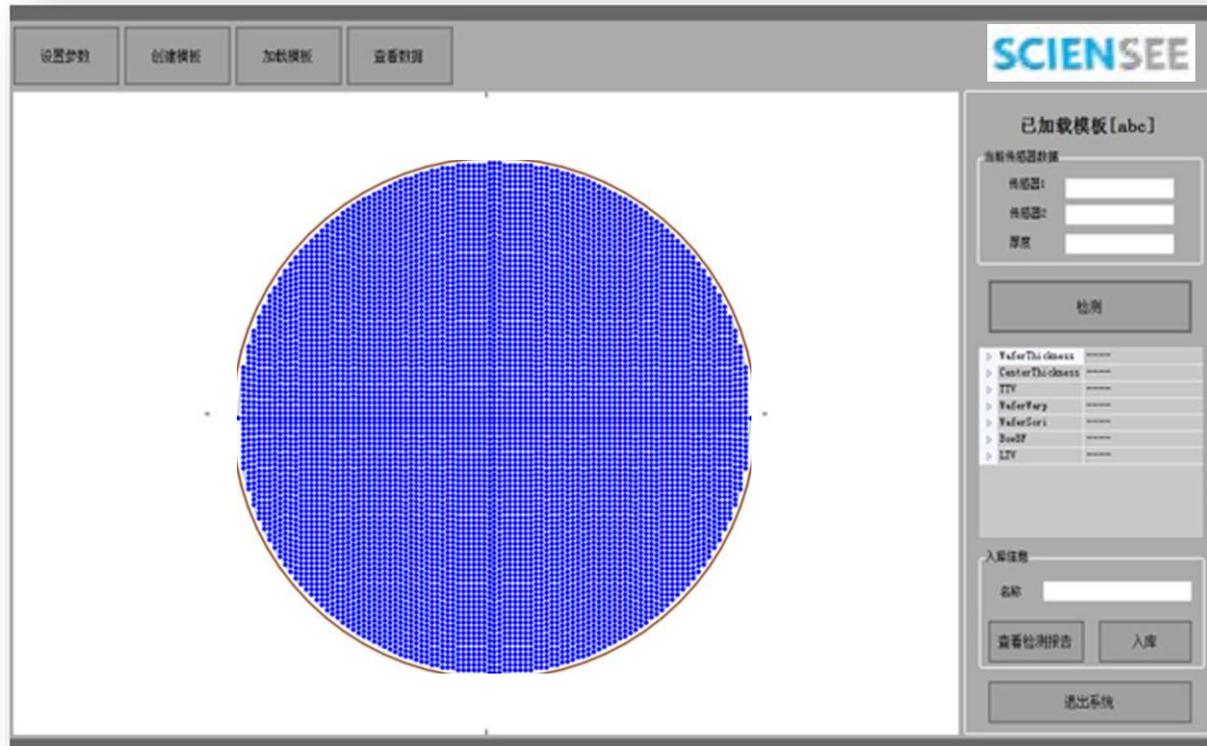
襯底片形貌檢測設備用於測量晶圓的BOW/WARP/TTV/LTV/Thickness，本設備可同時進行晶圓自動化分選(全自動版)，可根據需求定製成手動上片自動掃描(半自動版)；可以對接廠務MES系統，進行數據上傳。

系統採用上下同軸色散共焦傳感器，支援大部分透明或非透明材質的晶圓；可對應表面粗糙材質，因此可用於工藝流程中的切割、研磨、拋光、減薄等各環節。



全自動襯底片形貌掃描儀 TWS206

- BOW
- WARP
- TTV / LTV
- Thickness
- 支援檢測 4，6，8，12寸晶圓



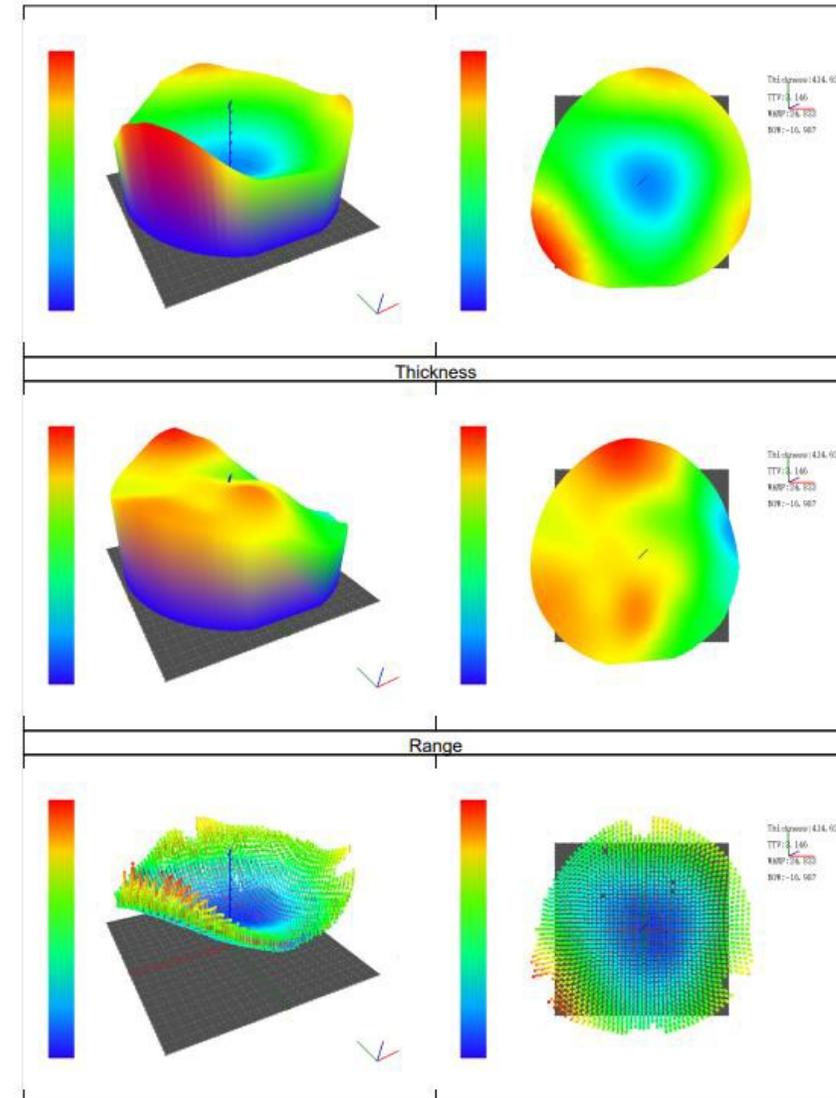
可設定掃描路徑

TWS206 — 自動生成分析報告

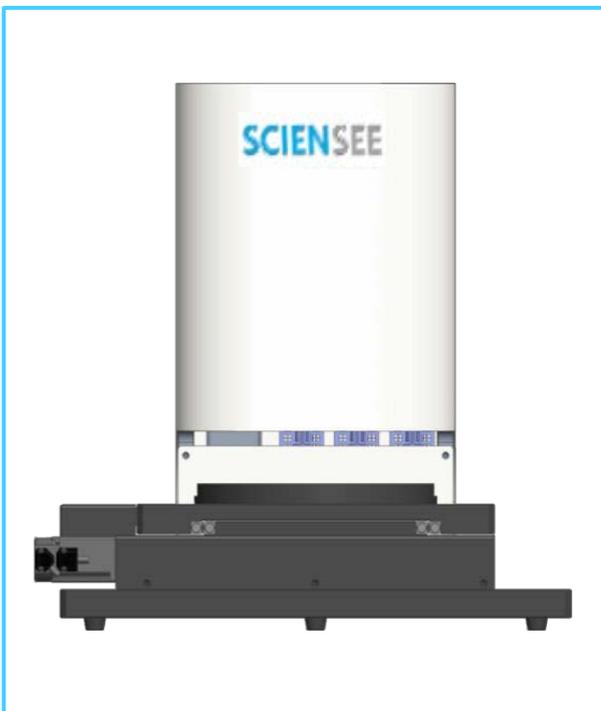


检测报告

Lot ID	1	Recipe	4Map-2-GaAs		SCIENCEE		
Start	2021/8/23 14:01:57	End	2021/8/23 14:03:44				
General Infos							
Task Started:2021/8/23 14:01:57							
Task Finished:2021/8/23 14:03:44							
Recipe Name:4Map-2-GaAs							
pdfGeneration Time:2021/08/23 14:36:13							
Task: Full sample inspectionmap (1/2)				Results			
Wafer ID	TTV	Warp	WarpMin	WarpMax	BowBf	Sori	SoriMin
1	3.146	24.833	0	0	-16.987	414.819	-8.792
Task: Full sample inspectionmap (2/2)				Results			
Wafer ID	SoriMax	Thickness	Thickness Min	Thickness Max	LtvMin	LtvMax	
1	16.022	414.629	412.592	415.738	0.011	0.598	
Task: Full sample inspection map				Wafer:20210823 143613 1			
Local Area Image							
LTV							
TopPlane							



LFM-SiC系列專門用於檢測SiC襯底片的瑕疵檢測儀，本設備為半自動桌面型（手動上片，自動掃描），可根據需求配套機械臂和上下料片庫，定製全自動設備。
系統採用精密光學顯像系統，結合獨有的演算法，對瑕疵進行檢測及歸類，提升了您對產品瑕疵的檢測效率。



LFM I型（針對SiC腐蝕片）

- TED錯位標定並統計
- TSD錯位標定並統計
- BPD錯位標定並統計
- 查看Map圖，支援review原始圖片
- 一鍵式測量，簡單易用
- 支援檢測 4，6，8寸晶圓

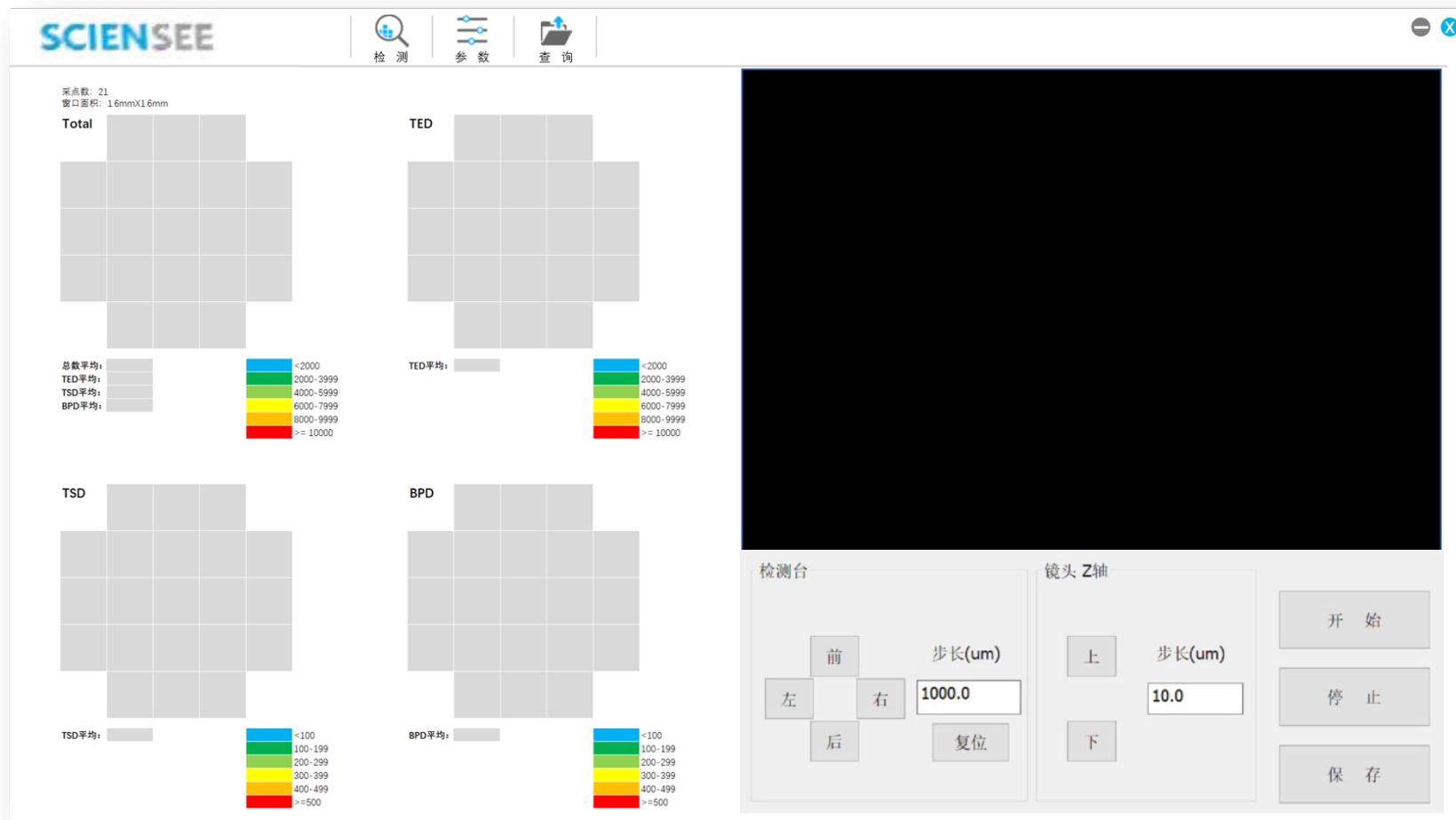
LFM II型（針對SiC拋光片）

- 微管標定統計
- 查看Map圖，支援review原始圖片
- 定性應力圖
- 一鍵式測量，簡單易用
- 支援檢測 4，6，8寸晶圓



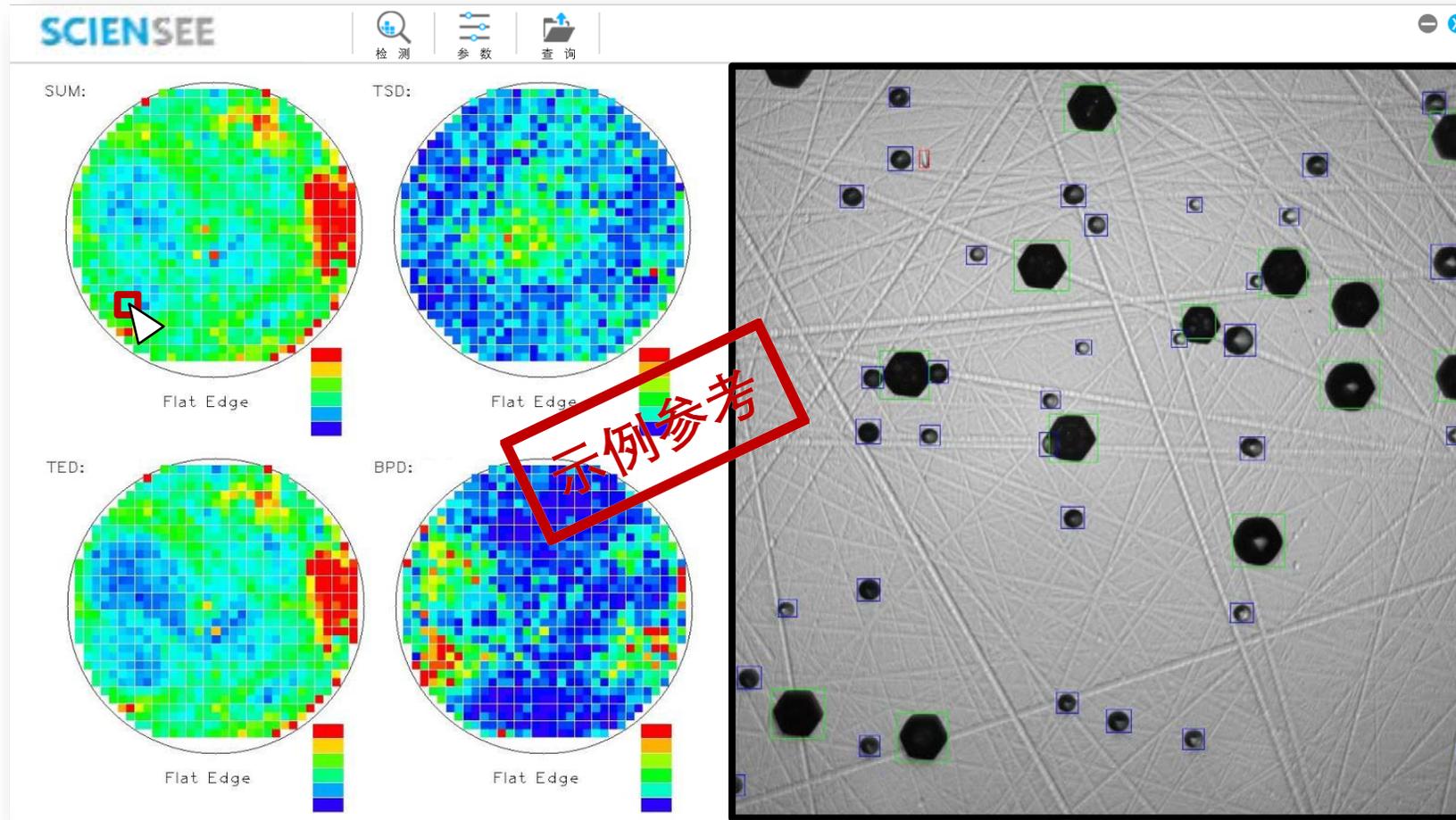
SiC瑕疵檢測儀系列
LFM-SiC I型
操作介紹

LFM-SiC I型 — 操作介面

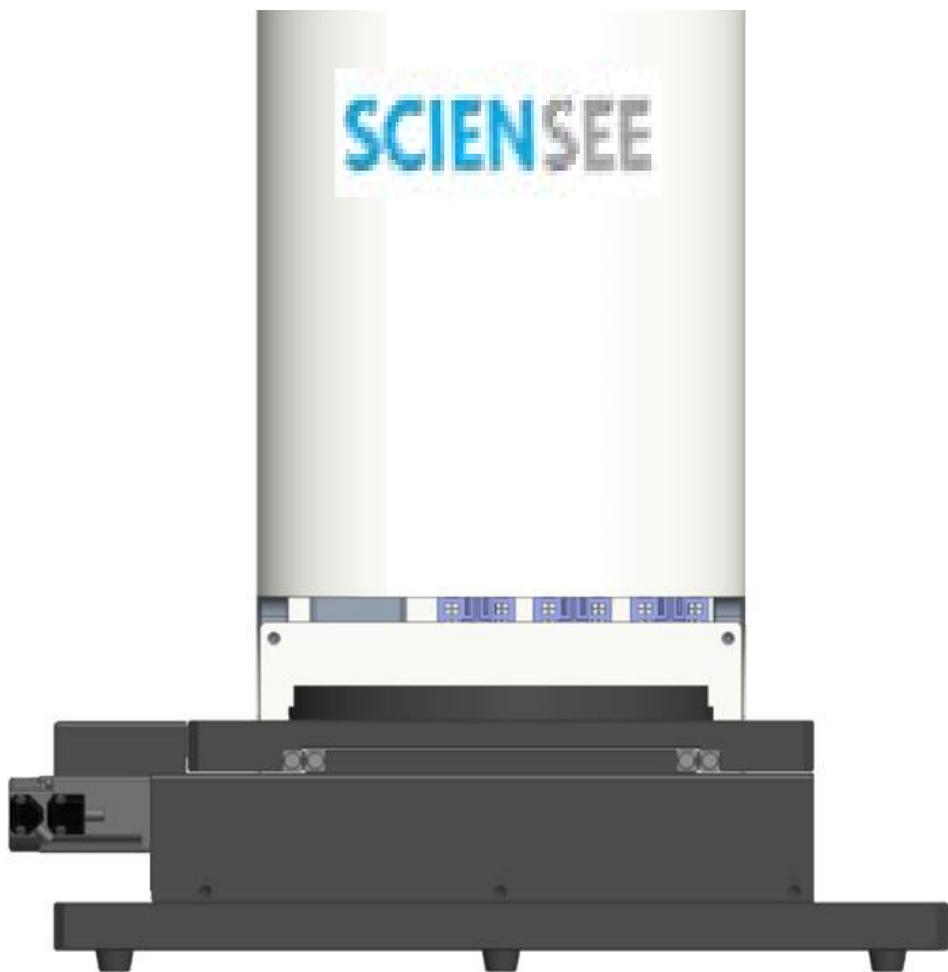


介面操作簡單易用

LFM-SiC I型 — 瑕疵顯示範例

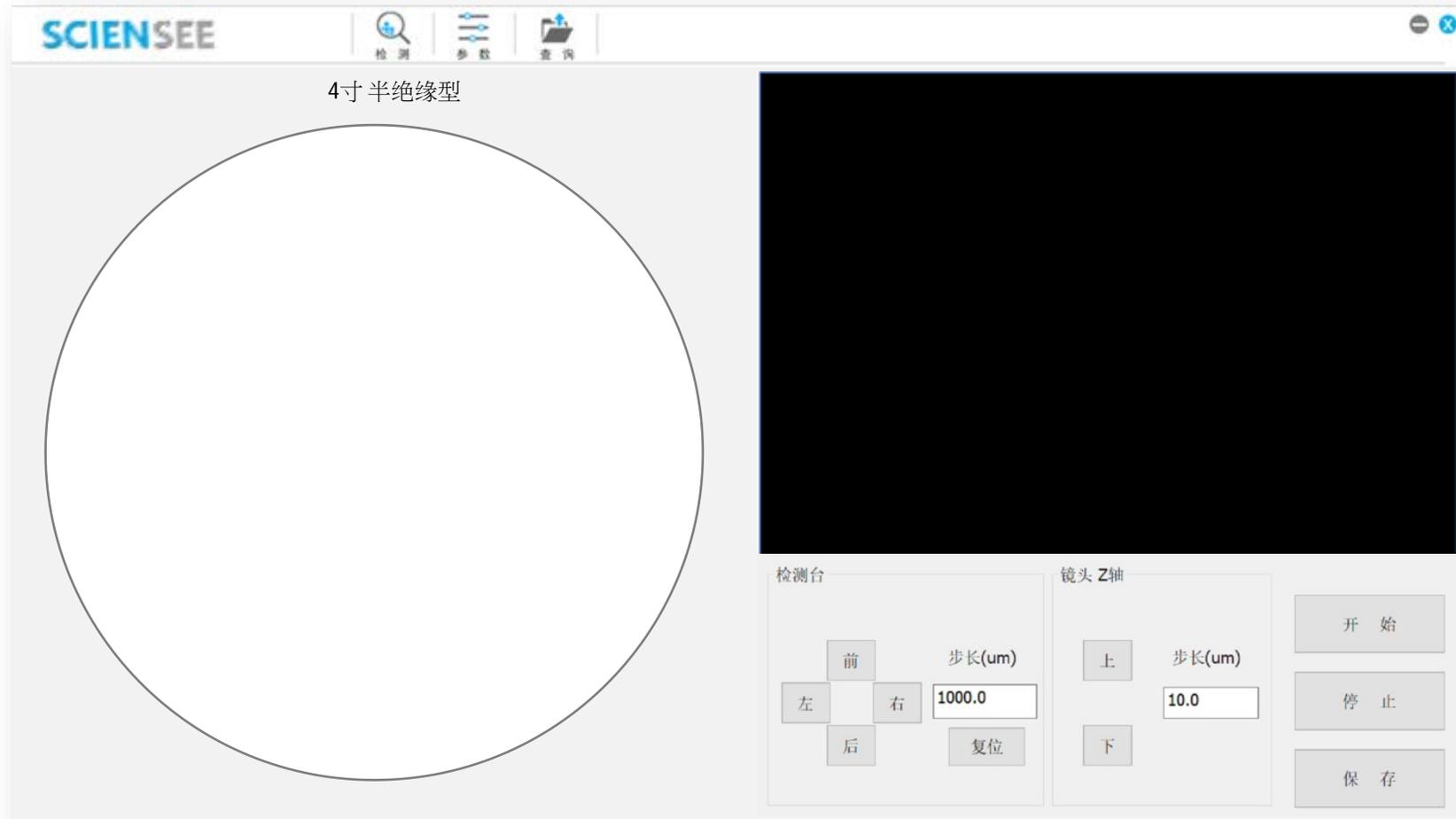


可追溯瑕疵圖像



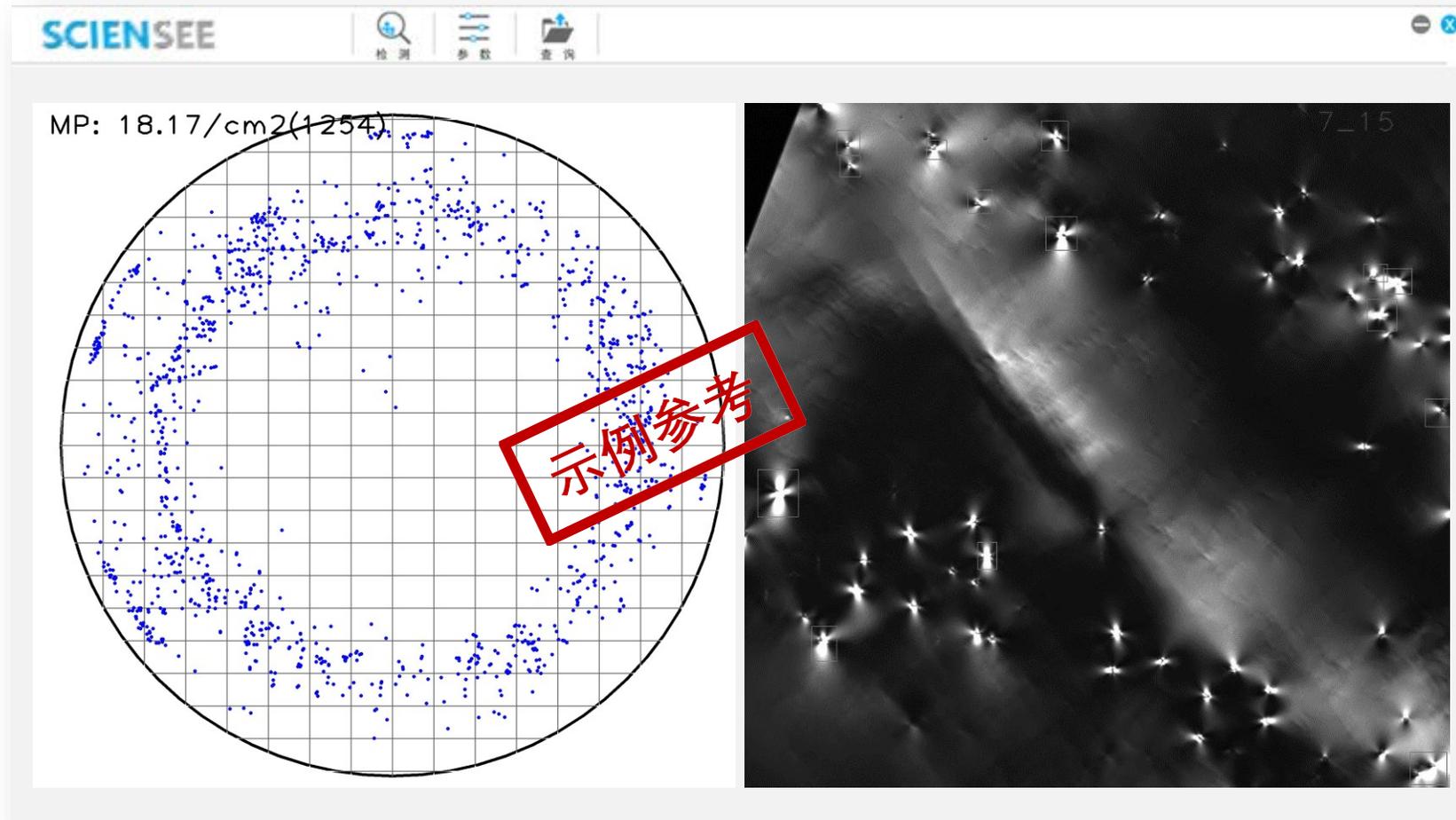
SiC瑕疵檢測儀系列
LFM-SiC II型
操作介紹

LFM-SiC II型 —— 操作介面



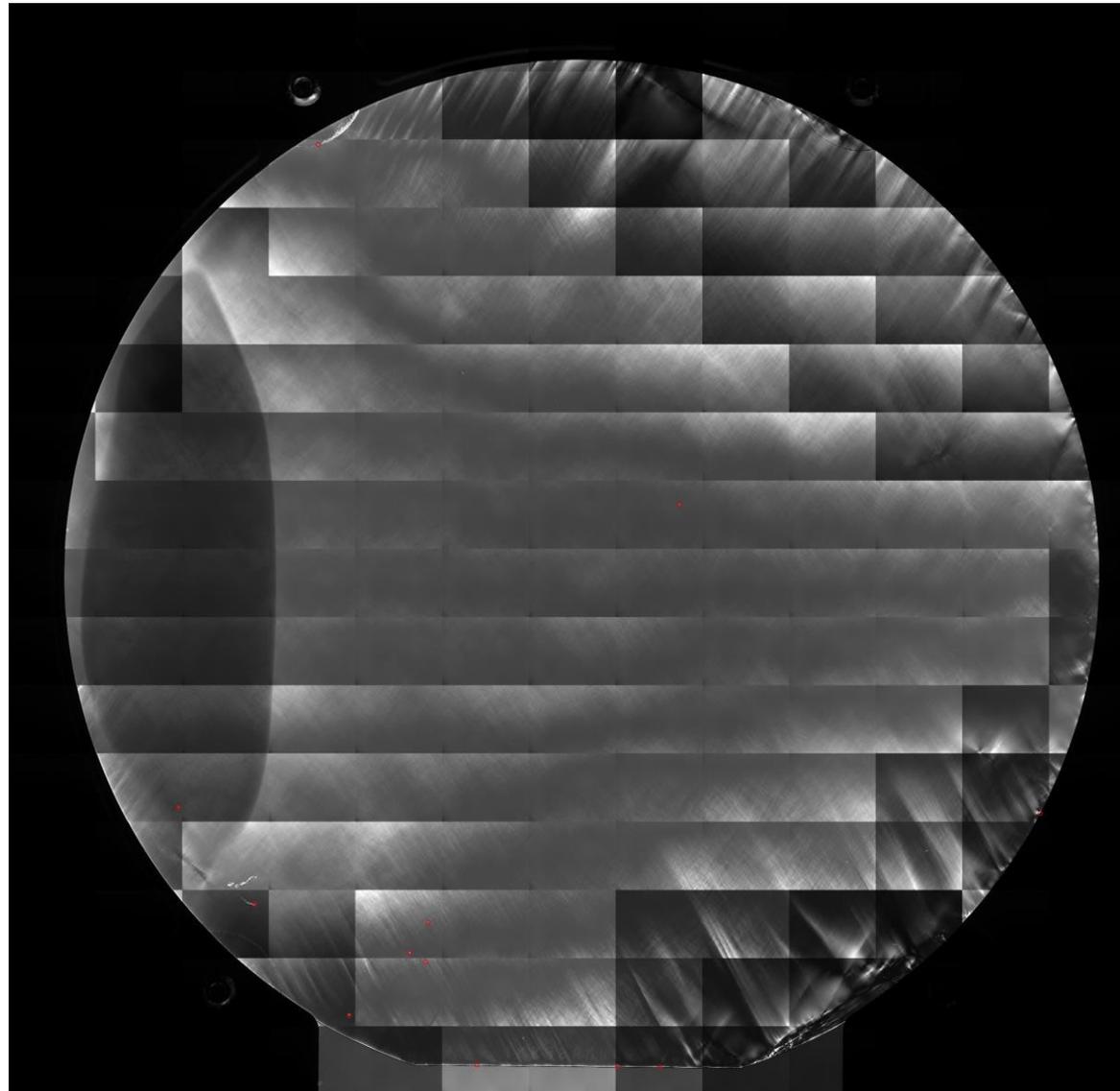
介面操作簡單易用

LFM-SiC II型 — 微管顯示範例



可追溯瑕疵圖像

LFM-SiC II型 — 應力顯示範例



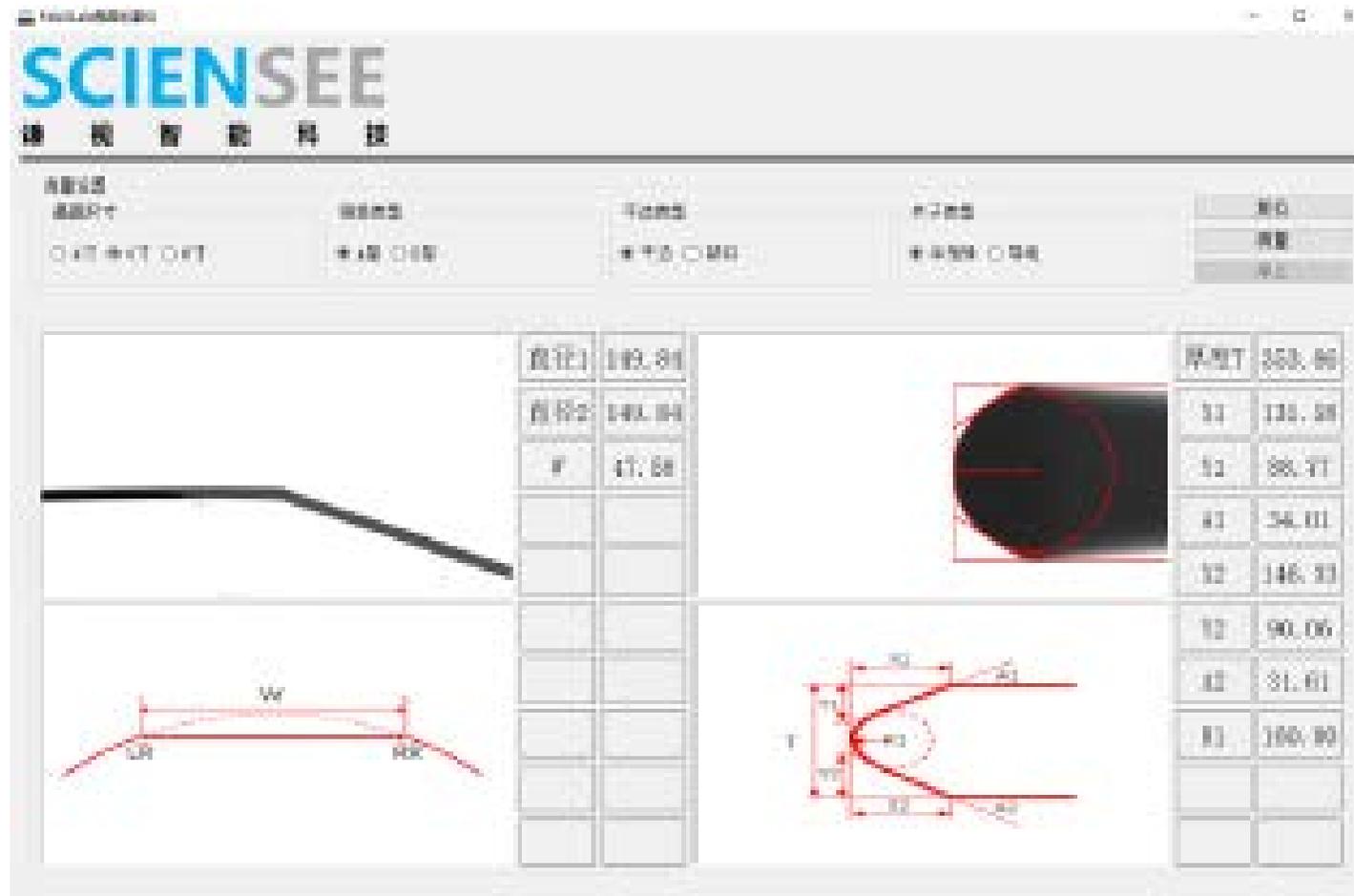
晶圓倒角及直徑測量儀可一鍵完成量測多個倒角形貌指標，本設備為半自動桌面型(手動上片自動掃描)，可根據需求配套機械臂和上下料片庫，定製全自動設備；可以對接廠務 MES系統，進行數據上傳。



Edge profiler

- 晶圓直徑：D
- 晶圓厚度：T
- 倒角形貌：X · Y · R · A
- 平邊，缺口測量
- 一鍵式測量，簡單易用
- 支援檢測 4 · 6 · 8寸晶圓

Edge-Profiler — 操作介面



介面操作簡單易用

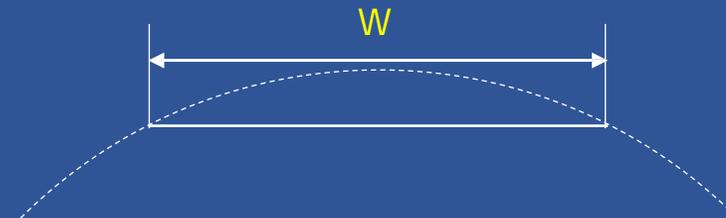
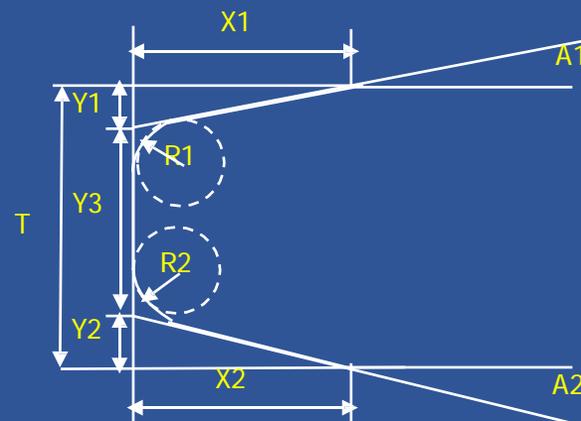
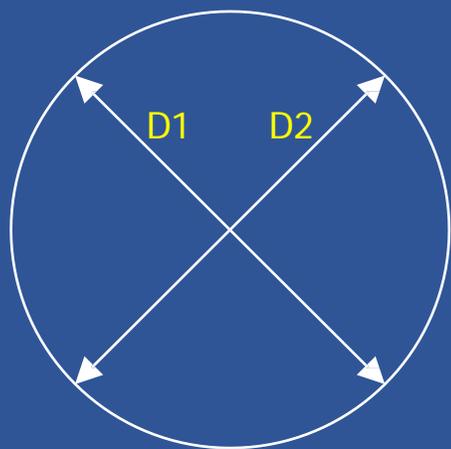
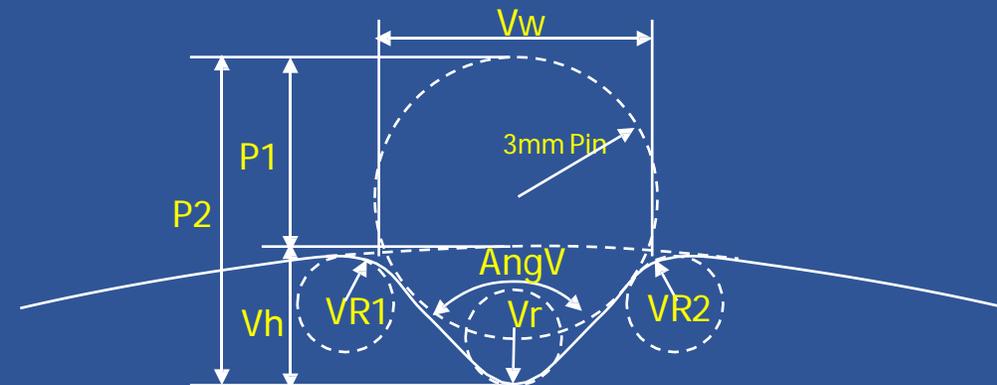
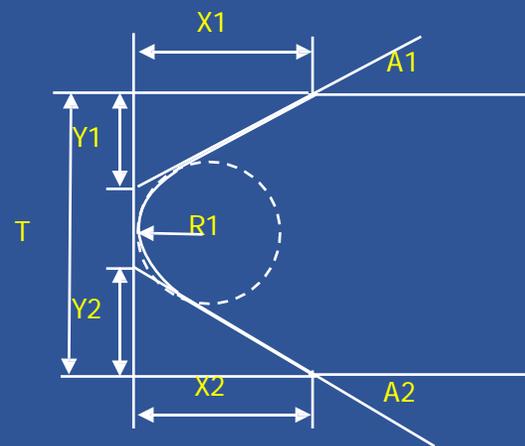
Edge-Profiler — 晶圓倒角及直徑測量



支援不同類型倒角形貌

長度精度 $\sim 0.005\text{mm}$

角度精度 $\sim 0.5^\circ$

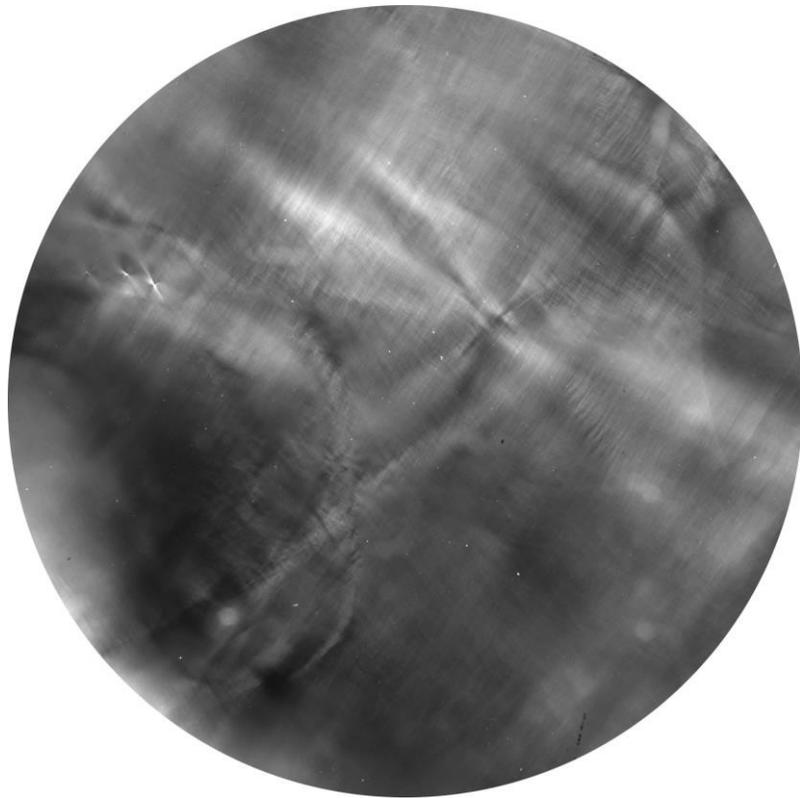


應力儀用於檢測晶圓內的應力分布，以光程差輸出應力定量分析，本設備為半自動桌面型(手動上片自動掃描)，可根據需求配套機械臂和上下料片庫，定製全自動設備；可以對接廠務MES系統，進行數據上傳。

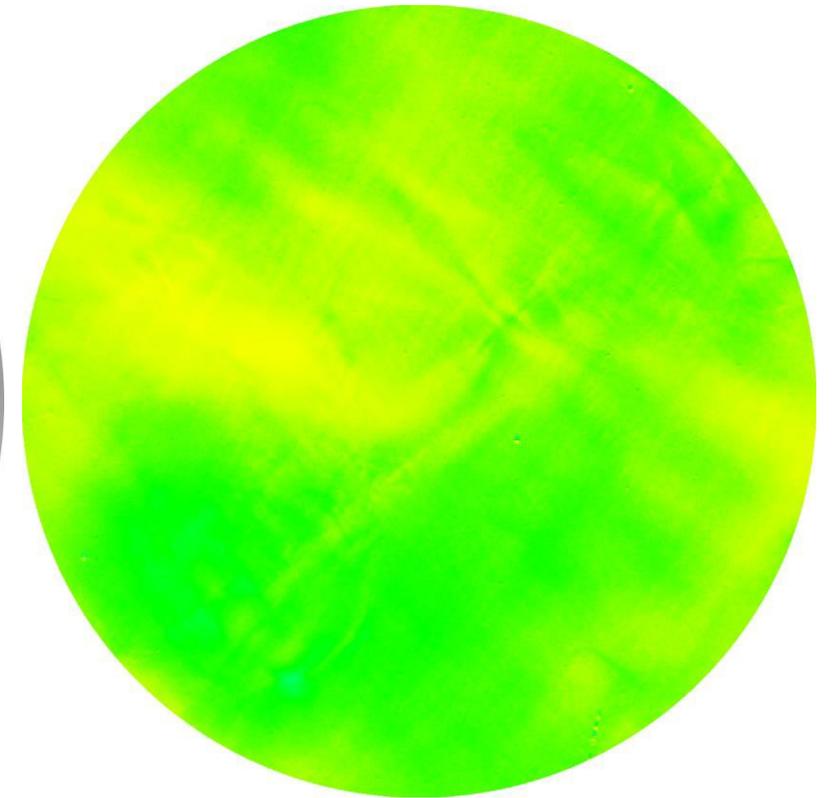


StressMap

- 應力圖快速成像(每片wafer<10s)
- 一鍵式測量，簡單易用
- 支援檢測 4，6，8寸晶圓



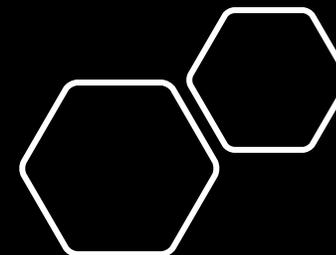
線偏光模式對比度更強



圓偏光模式可進行應力定量分析

- 具有良好的技術積累並努力達到最高性價比。
- 自主開發軟體和演算法，可按客戶需求進行定製化改進。
- 設備硬體系統為自主生產以節省成本，最大化優化客戶的投入產出比。
- 與客戶共同努力讓機台呈現出最好的性能，並更具您的需求定製小型機或者全自動機台。
- 提供及時的技術服務支援。

THANK YOU



提供工業爐及半導體設備等
全方位解決方案

磊拓科技股份有限公司

- Sales@latentek.com.tw
- +886-3-358 9738
- 桃園市藝文一街86-7號3F
- <http://www.latentek.com.tw>